This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

From:イデア特許事務所

+81526780166

2004/01/26 10:51 #081 P.014/021

1/1 ページ

esp@cenet - Document Bibliography and Abstract

COMPONENT MOUNTING SYSTEM

Patent Number:

JP2001313492

Publication date:

2001-11-09

Inventor(s):

IWATSUKA YOSHIHISA; SAKURAI HIROSHI

Applicant(s):

YAMAHA MOTOR CO LTD

Requested Patent:

JP2001313492

Application Number: JP20000128342 20000427

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05K13/02; B65G47/52

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate or reduce time loss by performing a mounting work on the next substrate just after a mounting work on one substrate, and carrying the already mounted substrate or another substrate during the mounting work.

SOLUTION: Two sets of substrate carrying conveyers 3 and 3' are arranged on a mounting device in a parallel state. Also, relay conveyer devices 30 and 31 are arranged at the upstream side and downstream side of the mounting device, and a relay conveyer 32 movable in a horizontal direction across the position corresponding to one of the two sets of substrate carrying conveyers 3 and 3' and the position corresponding to the other and a driving means constituted of a servo motor 37 for driving this are arranged on the relay conveyer devices 30 and 31.

Data supplied from the esp@cenet database - i2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出額公別番号 特別2001-313492

(P2001-313492A)

(43)公開日 平成13年11月9日(2001.11.9)

(51) Int.CL7	識別記号	FI	テーマコード(参考)
HO 5 K 19/02		H05K 13/02	U 3F044
B 6 5 G 47/52	101	B 6 5 G 47/52	101B 5E318

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

(21) 出願書号	特 里 2000-128342(P2000-128342)	(71)出獻人	000010076
(22)出瀬日	平成12年4月27日(2000.4.27)		ヤマハ発動機株式会社 静岡県磐田市新貫2500番地
	· ·	(72)発明者	岩塚 佳久
			静岡県磐田市新貝2500番地 ヤマハ発動機
			株式会社内
		(72)発明者	松井 博
			静岡県磐田市新貝2500番地 ヤマハ発動機
			保式会社内
	•	(74)代理人	100087828
			弗理士 小谷 悦司 (外2名)

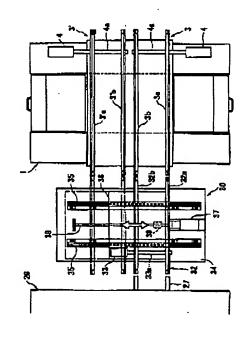
発終頁に続く

(84) 【発明の名称】 部品実装システム

(57)【要約】

【課題】 1つの基板に対する実装作業後に直ちに次の 基板に対する実装作業を行ない、その実装作業中に実装 済みの基板の扱出及び別の基板の扱入を行なうことがで きるようにして、タイムロスをなくし、もしくは減少さ せる。

【解決手段】 実装装置に2組の基板搬送用コンペア3,3′を並行する状態に配置する。また、実装装置の上流側及び下流側に中総コンペア装置30,31に、上記2組の基板搬送用コンペア3,3′のうちの一方に対応する位置と他方に対応する位置とにわたって横方向に移動可能な中様コンペア32と、これを駆動するサーボモータ37等からなる駆動手段とを設ける。



((2) 001-313492 (P20C1-31s|8

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被実装用の基板に対して部品の実装を行う実装装置を備え、上流側機器から実装装置へ上記基板を搬入し、部品実装後に上配基板を実装装置から下流側機器へ換出するようにした実装システムにおいて、上配実装装置に2組の基板搬送用コンベアを並行する状態に配置するとともに、この実装設置の上流側及び下流側に中継コンベア装置を配置し、この中継コンベア装置に、上記実装装置の各基板搬送用コンベアと同方向に延び、かつ、上記2組の基板搬送用コンベアのうちの一方に対応する位置と他方に対応する位置とにわたって機方向に移動可能な中機コンベアと、この中継コンベアを横方向に往復移動させる駆動手段とを設けたことを特徴とする部品実装システム。

【請求項2】 実装装置には、部品供給部と両基板搬送 用コンペア上の実装作業エリアとにわたって移動可能な 部品実装用のヘッドユニットを設けたことを特徴とする 請求項1記載の部品実装システム。

【請求項3】 上記実装装置を、基板搬送方向に直列に配置した複数の単位実装機により構成し、各単位実装機にそれぞれ2組の基板搬送用コンペアを並行する状態に配置するとともに、これら複数の単位実装機のうち最上流の単位実装機の上流側と最下流の単位実装機の下流側とに中継コンペアを配置したことを特徴とする請求項1又は2記載の部品実装システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、実装装置の上流側 及び下流側に中継コンペア装置を配置した部品実装シス テムに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来から、部品吸着用のノズル部村を有する実装用ヘッドを装備して、この実装用ヘッドにより被実装用のプリント基板に対して部品の実装を行うようにした実装機は一般に知られている。また、最近では、実装作業の高速性、機敏性及び品種切替えに対する適応性等を高めるため、複数台の実装機(モジュールマウンター)を基板設送方向に直列に配置し、プリント基板に対する多数種の部品の実装を分散して行い、つまりプリント基板に各実装機で数種類ずつの部品を順次実装しているようにしたモジュールタイプの実装装置も開発されている。

【0003】そして、上記実装機(もしくは複数台の実装機からなる実装機群)と、その上流側に配設されるローグ、クリームはんだ印刷機、ディスペンサ等と、下流側に配設されるリフロー炉、アンローダ等により実装ラインが構成されている。

【0004】上記実装機には所定方向に延びる基板撤送 用のコンペアが設けられ、上流側の機器から送られた基 板が上記コンペアで所定の実装作業位置まで搬送された 後、位置決め装置でこの位置に保持された状態で部品の 実装が行われ、部品実装後は再びコンペアで搬送されて 下流側の機器へ送られるようになっている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来の実 装システムによると、プリント基板を上流側から実装機 に搬入して所定の実装作業位置まで搬送するのに要する 時間、及び実装後の基板をコンペアで下流側へ搬出する のに要する時間が、実装作業の前後においてロスタイム となり、これが作業能率の向上の妨げとなっていた。

【0006】本発明はこのような事情に緩み、1つの基板に対する実装作業後に直ちに次の基板に対する実装作業を行ない、その実装作業中に実装済みの基板の搬出及び別の基板の搬入を行なうことができるようにして、上記タイムロスをなくし、もしくは減少することができる部品実装システムを提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、被実装用の基板に対して部品の実装を行う実装装置を備え、上流側機器から実装装置へ上記基板を搬入し、部品実装後に上記基板を実装装置から下流側機器へ搬出するようにした実装装置において、上記実装装置に2組の基板搬送用コンベアを並行する状態に配置するとともに、この実装装置の上流側及び下流側に中華コンベア装置を配置し、この中継コンベア装置に、上記実装装置の各基板搬送用コンベアと同方向に延び、かつ、上記2組の基板搬送用コンベアと同方向に延び、かつ、上記2組の基板搬送用コンベアのうちの一方に対応する位置と他方に対応する位置とにわたって横方向に移動可能な中継コンベアと、この中継コンベアを横方向に往復移動させる駆動手段とを設けたものである。

【0008】この構成によると、上流側の中継コンベア 装置の中継コンベアが実装装置の一方の基板搬送用コン ベアに対応するようにセットされた状態で上記一方の基 板搬送用コンベア上の中継コンベアを経た基板が搬入さ れた後、この基板に対する実装が行われる一方、中継コ ンベアが他方の基板搬送用コンベアに対応する位置に移 動して、次の基板が上記他方の基板搬送用コンベア上に 搬入される。

【0009】また、一方の基板搬送用コンベア上の基板に対する実装が終了すれば、直ちに他方の基板搬送用コンベア上の基板に対する実装作業に移るとともに、実装済みの基板が一方の基板搬送用コンベアから下流側の中継コンベア装置の中継コンベアを経てその下流に搬出された後、中継コンベアが他方の基板搬送用コンベアに対応する位置へ移動する。

【0010】こうして、基板に対する実装作業中に実装 済みの基板の搬出及び次の基板の搬入が行われて、実装 作業中断時間がなくなり、もしくは減少することとな る。

【0011】この発明において、実装装置には、部品供

(3) 001-313492 (P2001-315|8

始部と両基板般送用コンベア上の実装作業エリアとにわ たって移動可能な部品実装用のヘッドユニットを設ける ようにすれば、単一のヘッドユニットによりながら、能 事良く実装作業が行われる。

【0012】また、茎板搬送方向に直列に配置した複数の単位実装機により構成したモジュールタイプの実設装置に適用する場合は、各単位実装機にそれぞれ2組の基板搬送用コンペアを並行する状態に配置するとともに、これら複数の単位実装機のうち最上流の単位実装機の上流側と最下流の単位実装機の下流側とに中継コンベアを配置すればよい。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の実施形態を図によって説明する。

【0014】図1は部品実装装置とその上流側及び下流側に配置される機器とを含めた部品実装システム全体の概略構成を示しており、この図に示す部品実装システムは、複数台の実装機(モジュールマウンタ)1を基板搬送方向に直列に配置した実装機群からなるモジュール型の部品実装装置と、上流側機器26及び下流側機器28と、上流側及び下流側の中継コンペア設置台(中継コンペア装置)30、31とを含んでおり、具体的には次のような構造となっている。

【0015】上記実鎮機1は、図2及び図4に示すよう に、プリント基板Pの扱入、搬出を可能とするように基 台2上に配置された基板撤送用コンペアを備え、特に本 発明では、第1の基板搬送用コンペア3及び第2の基板 搬送用コンベア3 の2組が互いに並行して所定の基板 搬送方向に延びるように配置されている。基板搬送用コ ンベア3, 3'は、それぞれ一対ずつのベルトコンベア 3a.3b及び3~a,3~bからなり、プリント基板 Pの阿側辺部を支持して扱送し得るようになっている。 【0016】上記各差板搬送用コンペア3、3′に対し てそれぞれ、搬送用モータ4とこのモータ4の回転を一 対のベルトコンペアの各駆動プーリ(図示せず)に伝え る駆動戦4 aとからなる撤送用駆動機構が設けられ、各 搬送用駆動機構により各基板搬送用コンペア3,3′が 個別に駆動されるようになっている。なお、上流側から 扱入したプリント基板Pを所定の実装作業位置で停止さ せて実装作業を行い得るように、図外の出没可能なスト ッパー及びプッシュアップピン等からなる位置決め装置 が、各基板搬送用コンベア3、31に対してそれぞれ配 設されている。

【0017】さらに単位実装機1は、図2及び図3に示すように、プリント基板Pに実装される電子部品を供給する部品供給部5と、部品吸着用のノズル部材20を有するヘッドユニット6と、このヘッドユニット6及びノズル部材20を駆動する後記サーボモータ等の駆動手段とを備えている。

【0018】上記部品供給部5は、上記2組の基板級送

用コンベア3.3^{*}が配置されている部分を挟んでその 両側に配設されている。この部品供給部5には電子部品 を供出可能とするフィーダーが設けられ、例えば多数列 のテープフィーダー5 aが配設されている。

【0019】また、上記ヘッドユニット6は、基台2の上方に配置され、部品供給部うから部品をピックアップして上記実装作業位置にあるプリント基板Pに装着し得るように、X軸方向(コンペア3,3°による搬送方向)及びY軸方向(水平面上でX軸と直交する方向)に移動することができるようになっている。

【0020】すなわち、上記基台2上には、Y軸方向に 延びる一対の固定レール7と、Y駐サーボモータ9によ り回転駆動されるボールねじ軸8とが配設され、上記固 定レール7上にヘッドユニット支持部村11が配置され て、この支持部材11に設けられたナット部分(図示せ ず)が上記ボールねじ軸8に螺合している。また、上記 支持部材11には、X軸方向に延びるガイド部材13 と、X軸サーポモータ15により回転駆動されるボール ねじ軸14とが配設され、上記ガイド部材13にヘッド ユニット6が移動可能に保持され、このヘッドユニット 6に設けられたナット部分(図示せず)が上記ボールね じ帕14に螺合している。そして、Y軸サーボモータ9 の作動によりボールねじ軸8が回転して上記支持部村1 1がY軸方向に移動するとともに、X軸サーボモータ1 5の作動によりボールねじ軸14が回転して、ヘッドユ ニット6が支持部材11に対してX軸方向に移動するよ うになっている。

【0021】上記ヘッドユニット6には、一乃至複数の ノズル部材20が昇降及び回転可能に設けられるととも に、ノズル部材20を昇降させる乙軸サーボモータ21 及びノズル部材20を回転させるR軸サーボモータ22 が装備されている。なお、ノズル部材20の昇降駆動は エアシリンダにより行われるようにしてもよい。

【0022】また、上記基台2上にはCCDカメラ及び 照明等からなる部品認識用の最像装置25が装備されて おり、図示の例では、基板搬送用コンペア3.3°のY 軸方向両側においてそれぞれ部品供給部5がX軸方向両 側に分散され、その間に最像装置25が配数されてい る。

【0023】このようなコンペア3、ヘッドユニット6、サーボモータ9、15、21、22等の駆動手段、 協議装置25等が図1に示す各単位実装機1のハウジング内に設けられ、コンペア3、3、の両端がハウジングの側盤から外方に臨み、各単位実装機1のコンペア3、3、が直列に連なるように複数台(図1に示す例では4台)の単位実装機1が配列されている。

【0024】また、図1において、上流側機器26は上記モジュール型部品実装装置とは別のタイプの実装機、あるいは実装の前工程の処理を行うディスペンサ等の機器であり、下流側機器28は上記モジュール型部品実装

i

!(4) 001-313492 (P2001-31s|8

装置とは別のタイプの実装機、あるいは実装の後工程の 処理を行うリフロー炉等である。この上流側機器26及 び下流側機器28にはそれぞれ一組の基板搬送用コンベ ア27,29が設けられている。

【0025】上記実装機群と上流側機器26との間及び上記実装機群と下流側機器28との間にはそれぞれ、中継コンペア設置台(中継コンペア装置)30,31が設けられている。各中継コンペア設置台30,31には、上流側機器26と実装機群との間や実装機群と下流側機器28との間でプリント基板Pの受け渡しを行うための中離コンペア32が設けられている。この中継コンペア32は、各単位実装機1に設けられているコンペア3,3′のうちの1組と同様に、一対のベルトコンペア32a,32bを有し、搬送用モータ33及び駆動軸33aからなる搬送用駆動機構によってベルトコンペア32a,32bが駆動されることにより、プリント基板Pの両側辺部を支持して搬送するようになっている。

【0026】本発明では特に上記中継コンベア32が、 実装機1の第1のコンベア3に対応する位置と第2のコンベア3、に対応する位置とにわたって横方向(Y方向)に移動可能とされ、サーボモータ等からなる横移動 用駆動機構により中継コンベア32の横方向移動が行われるようになっている。

【0027】このような中継コンペア32を横移動させるための機構を、図4を参照して具体的に説明する。なお、この図は中総コンペア設置台30とこれに続く実装機の平面図であるが、中継コンペア設置台30については中能コンペア32及びこれを検移動させる機構を明確に表すために上部カバーを取り外した状態で示し、また実装機については2組のコンペア3,3′を明確に表すために上部カバー及びヘッドユニットを取り外した状態で示している。また、この図では中継コンペア32を横移動させるための機構を上流側の中継コンペア設置台30について示しているが、下流側の中継コンペア設置台31にも同様の機構が設けられている。

【0028】中継コンペア設置台30の差台34上には、阿側部がガイド35に支持されて横方向に移動可能となった可動台板36が配置されるとともに、サーボモータ37に連結されたボールねじ軸38が可動台板36の下方にガイド35と平行に配置され、可動台板36の下面に設けられたナット部39が上記ボールねじ軸38に場合している。

 ンベア32等を保持する可動台板36が移動するように なっている。

【0030】上記搬送用モータ33及びサーボモータ37は、後述するコントローラ50(図1参照)により制御されるようになっている。

【0031】なお、上記の中総コンペア32を横移動させる機構に加え、プリント基板の幅に応じて一対のペルトコンペア32a,32bの間隔を変更可能とするコンペア間隔調整機構も中継コンペア設置台30,31に設けられており、また単位実装機1においても2組のコンペア3,3、対してそれぞれコンペア間隔調整機構は従来から知られている。このコンペア間隔調整機構は従来から知られているため図示は省略するが、一対のベルトコンペアのうちの一方を他方に対して接離する方向(Y軸方向)に移動可能に支持するガイドと、この方向にベルトコンペアを移動させるボールねじ軸及びサーボモータ等からなる駆動機構とを備える。そして、単位実装機1ではこのようなガイド及び駆動機構が基台2上に2組配設され、中様コンペア設置台30,31ではこのようなガイド及び駆動機構が例えば可動台板36上に配設されている。

【0032】なお、当実施形態の実装用システムにおいては、図1に示すように、中様コンペア設置台30にコントローラ50が設けられ、このコントローラ50が、内部配線を介して上記搬送用モータ33及びサーボモータ37等に電気的に接続されるとともに、ワイヤーハーネス51を介して上記実装機群の各単位実装機1及び下流側の中継コンペア設置台31にも電気的に接続されている。

【0033】さらにコントローララのが設けられている中様コンペア設置台30には、実装機用ビジョンモニターラ4及び実装機操作用モニターララが装備され、各モニター54、55も中様コンペア設置台30の内部配線を介してコントローラ50に接続されている。

【0034】そして、上記コントローラ50により、各単位実装機1に設けられたサーボモータやその他各種の駆動手段、及び中継コンベア設置台30,31に設けられたモータ等が統括的に制御されるようになっている。【0035】以上のような当実施形態の部品実装システムの作用を、次に説明する。

【0036】上流関機器26からはアリント基板Pが1 枚ずつ所定時間間隔で中継コンベア台車30の中継コン ベア32上へ送られ、さらに中継コンベア32からその 下流の単位実験機1へプリント基板Pが送られて実装が 行われる。

【0037】この場合に、例えば中継コンペア32が先 ず図4に実態で示す第1位置にある状態でこの中継コン ペア32から単位実装機1の第1の蓋板搬送用コンペア 3ヘブリント基板Pが送り込まれ、このブリント基板P が所定の実装作業位置に達した後、このプリント基板P

(5) 001-313492 (P2001-31si8

に対する実装作業が開始されるが、その一方で、次のアリント基板Pが中継コンベア32上に送り込まれてから、サーボモータの駆動により中継コンベア32から単位実装機1の第2の基板搬送用コンベア3、ヘブリント基板Pが送り込まれ、このコンベア3、上の所定の実装作業位置まで搬送される。このような搬送作業は第1の基板搬送用コンベア3、上の所定の実装作業の基板搬送用コンベア3、上の所定の実装作業位置でアリント基板Pが特機する。

【0038】そして、単位実装機1のヘッドユニット6が第1の基板投送用コンベア3上のプリント基板Pに対する実装を終了すると、そのプリント基板Pが下流倒に扱出される一方、ヘッドユニット6が直ちに第2の基板投送用コンベア3、上のプリント基板Pに対する実装作業に移る。

【0039】さらに、第2の基板搬送用コンベア31上のプリント基板Pに対する実装中に、中継コンベア32が第1位置に戻って次のプリント基板Pを第1の基板搬送用コンベア3上に送り込み、ヘッドユニット6が第2の基板搬送用コンベア31上のプリント基板Pに対する実装を終了すると、そのプリント基板Pが下流側に搬出される一方、ヘッドユニット6が直ちに第1の基板搬送用コンベア3上のプリント基板Pに対する実装作業に移る。

【0040】このようにして、一方の基板搬送用コンペア上のプリント基板Pの実装中に他方のコンペア上にプリント基板Pが搬入されるという作業が繰り返され、これによってプリント基板の搬入、搬出のための実装作業中断時間(ロスタイム)がなくなり、もしくは大幅に減少する。

【0041】モジュール型部品実装装置の最上流の単位 実装機に続く他の単位実装機においても、それぞれ2組 の基板搬送用コンペアが設けられていることにより、一 方の基板搬送用コンペアに搬入されたアリント基板せが このコンペア上で実装されている間に、上流の単位実装 機で実装を終えた次のアリント基板が他方の基板搬送用 コンペアに搬入されるという作業が繰り返される。

【0042】また、モジュール型部品実装装置の最下流の単位実装機1と下流順機器28との間では、単位実装機1の一方〈例えば第1〉の基板搬送用コンベア3上のプリント基板に対する実装が終了すれば、ヘッドユニット6が他方(例えば第2)の基板搬送用コンベア3、上のプリント基板Pに対する実装作業に移る一方、実装済みのプリント基板Pが一方の基板搬送用コンベア3からこれに対応する位置にセットされた下流側中継コンベア1車31の中継コンベア32に送り出されて、さらに下流側機器へ送られた後、中継コンベア32が他方の基板搬送用コンベア31に対応する位置に移動するという動

作が繰り返される。

【0043】こうして、モジュール型部品実装装置全体として能率良く作業が行われることとなる。

【0044】なお、本発明の装置の具体的構造は上記実施形態に限定されず、種々変更可能である。

【0045】例えば、図示の例では4台の単位実装機1 でモジュールタイプの実装装置を構成しているが、単位 実装機の台数は要求に応じ速宜変更して差し支えなく、 また、必ずしもモジュール化したものに限らず、1台の 実装機と上流側機器及び下流側機器との間に中継コンベ アを組み込むようにしたものであってもよい。

【0046】また、上記実施形態では単位実装機1に、 部品供給部と2框の基板搬送用コンベア3,3'上の各 実装作業エリアとにわたって移動可能な単一のヘッドユニットを設けているが、各基板搬送用コンベア3,3' に対応させて、個別に移動可能な2つのヘッドユニット を設けるようにしてもよい。

[0047]

【発明の効果】以上のように本発明は、上記実装装置に 2組の基板撤送用コンベアを並行する状態に配置すると ともに、この実装装置の上流側及び下流側に配置した中継コンベア装置に、上記 2組の基板搬送用コンベアのうちの一方に対応する位置と他方に対応する位置とにわたって横方向に移動可能な中継コンベアとこれを駆動する 駆動手段とを設けているため、一方の基板搬送用コンベア上の基板に対する実装作業中に他方の基板搬送用コンベアを利用して実装済みの差板の搬出及び次の基板の搬入を行うことができ、基板搬入、搬出時の実装作業中断によるタイムロスをなくし、もしくは大幅に減少することができ、作業能率を高めることができるものである。【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の部品実装システムの一実施形態を示す 概略図である。

【図2】 奥装機の一例を示す概略平面図である。

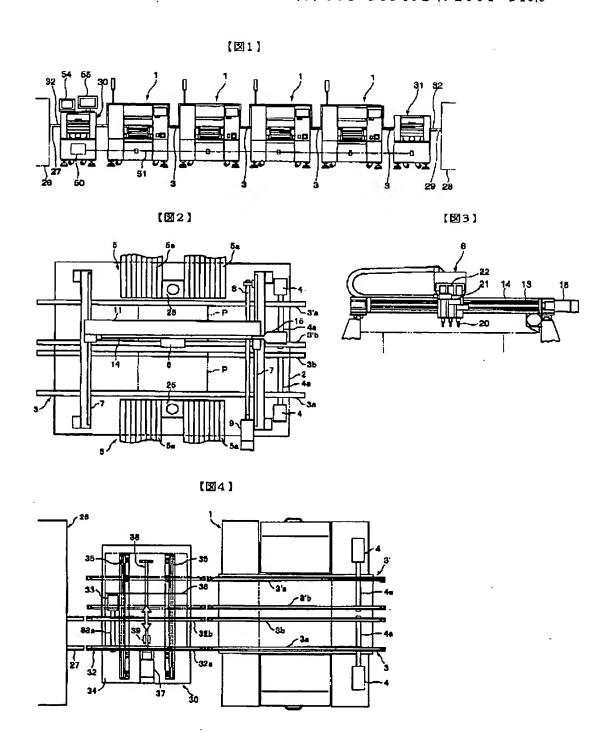
【図3】実装機におけるヘッドユニット配置部分の概略 正面図である。

【図4】中雄コンベア設置台と実装機及び上流側機器の 一部とを示す概略平面図である。

【符号の説明】

- 1 単位実發機
- 3,3′ 基板扱送用コンペア
- 4 搬送用モータ
- 5 部品供給部
- 6 ヘッドユニット
- 30,31 中難コンベア設置台
- 32 中継コンベア
- 33 搬送用モータ
- 37 中継コンベア横移動用のサーボモータ

!(6) 001-313492 (P2001-31\$|8



From:イデア特許事務所

+81526780166

2004/01/26 10:54 #081 P.021/021

(7) 001-313492 (P2001-31s|8

フロントページの続き

Fターム(参考) 3F044 AA13 CE02

5E313 AAO2 AA11 AA15 DD01 DD02 DD05 DD07 DD12 DD50 BE02 EE24 EE25 EE35 FG01 FG02 FG06 FG10